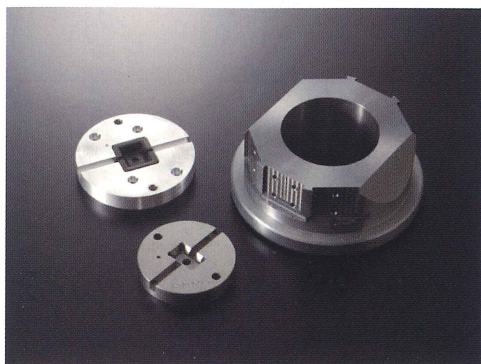


・営業品目 概要

特殊材料や特殊処理など、さまざまな加工部品から高精度部品や微細部品など難易度の高い加工部品までお客様のニーズに対応した商品をご提供しております。

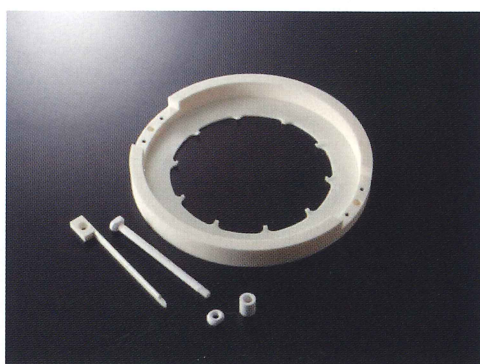
- ・半導体関連部品
- ・超硬部品
- ・セラミック部品
- ・特殊樹脂部品

- ・切断、成形金型部品
- ・モールド金型部品 切断、成形金型部品



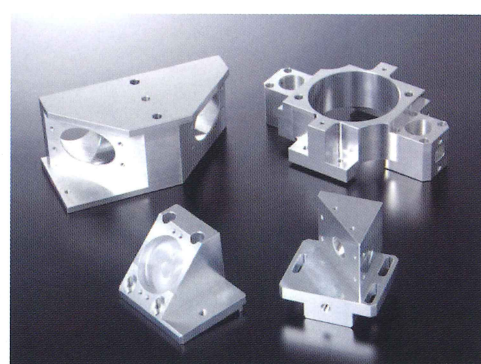
半導体テスト用
位置決めポケット

材質：SUS304 セミコン Ti ポリマー



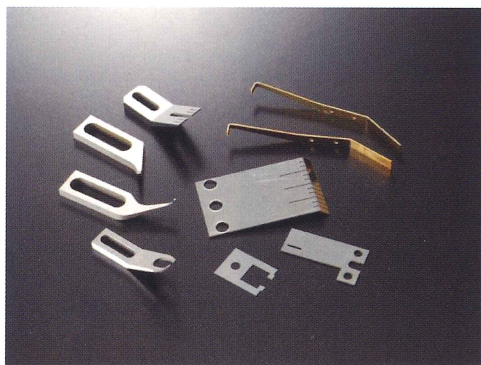
半導体前工程向セラミック部品

材質：アルミセラミック SiN ギルコニア



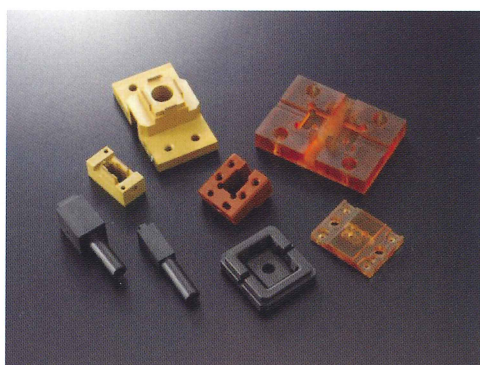
精密加工部品、光学系部品

材料：アルミ類



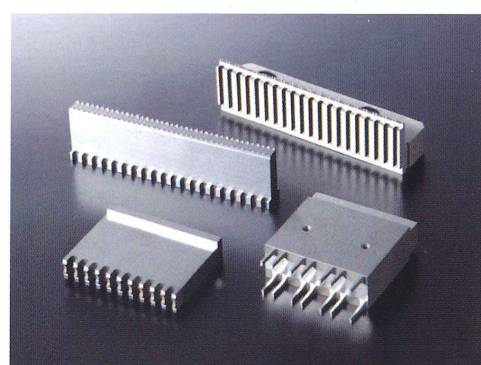
半導体組立用
リードフレームクランプ部品

材質：SKS-3 SUS304 SUS301



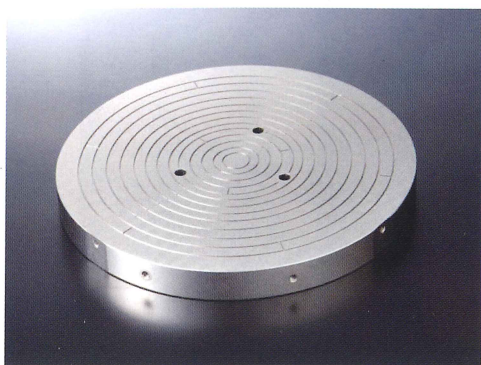
精密樹脂加工部品

材料：セミコン・ベスベル・PES
PEEK・テフロン・ダイロン



精密金型部品

材質：SKD-11 超硬 超微粒子超硬
セラミック



プラズマ用チャック

厚付金メッキ 10~20 μ 平坦度 0.002 以内